



MSL FPGA INC 晶片參數

■ 芯片概述

SN74HCS16507PWR是来自MSL FPGA INC美时龙的一款8位并行/串行输入移位寄存器，采用TSSOP-16封装，主要参数如下：

■ 核心参数

工作电压范围：2V~6V

工作温度：-40 ~+125

输出类型：开漏(需外接上拉电阻)

封装形式：16-TSSOP表面贴装封装，宽度4.4mm

■ 功能特性

并行/串行转换：支持8位并行数据加载或串行数据移位输出。

开漏输出结构：需外接上拉电阻，支持线或逻辑和电平转换。

低功耗设计：典型静态电流仅100nA，适合电池供电场景。

抗干扰能力：CMOS输入具有噪声抑制特性，兼容TTL电平。

■ 应用场景

工业控制：用于PLC的I/O扩展模块，实现多路信号串行传输。

汽车电子：符合AEC-Q100标准，适用于车载传感器数据采集。

通信设备：在UART/SPI接口中实现数据缓冲和协议转换。